

日時：2018年7/12(木)16:00～7/13(金)17:30

開催場所：パナソニックリゾート大阪 大阪府吹田市青葉丘南10-1 TEL 06-6877-0111

- ・本ワークショップは恒例の聴講者参加型を特徴としています。
- ・分野・競合を超えた技術者間の交流の場を重視。各業界における著名な先生方をイブニング・ナイトセッション講師にお招きし実装関連技術の将来像を語って頂きます。事前希望で振り分けた講師毎のグループで議論して頂けます。

**\* イブニング&ナイトセッション(1日目) 「JISSO 5.0 時代の技術的特異点の探索」**

講師6名のショート講演の後、各講師グループに分かれて討議。事前希望でグループ分け

加柴 良裕氏	大阪大学 特任教授	『パワーデバイス性能を引き出すための実装技術』
八甫谷明彦氏	(株)東芝 技術開発センター 主幹	『分子接合技術による次世代配線形成、放熱技術』
池田 博明氏	(有)ナプラ 執行役員・CTO	『パワーデバイス用 Cu-Sn IMC 接合材 -特性と応用-』
西木 直巳氏	大阪大学 招聘教授/パナソニック(株) 嘱託	『基礎研究から事業立ち上げへ』
松川 公洋氏	京都工芸繊維大学 特任教授	『有機無機ハイブリッドの創成と光学材料への期待』
菅野 俊夫氏	台湾 ITRI 産業化ディレクター	『日台企業文化の差異』

\*事前申し込みの方々には、一緒に語り明かしたいナイトセッション講師を選択頂けます。

**\* 基調講演(2日目)**

益 一哉氏	東京工業大学 学長	『IoT 時代でデバイス関係技術は如何に生き残るのか?』 - CMOS-MEMS 超高感度慣性センサの開発を事例に -』
小川 立夫氏	パナソニック(株) 執行役員 生産技術本部 本部長	『パナソニックの目指すモノづくりの姿 ~創業100周年を迎えて~』

**予定**

7/12(木)

- 15:00～ チェックイン (自由時間)
- 16:00～ イブニングセッション 第1部  
(講師プレゼンテーション 25分×3名)
- 17:30～ イブニングセッション 第2部  
(講師プレゼンテーション 25分×3名)
- 19:00～ レセプションパーティー
- 21:00～ ナイトセッション 第1部  
(各班に分かれて講師とともにテーマを掘り下げる)
- 22:00～ ナイトセッション 第2部  
(夜中まで軽食をつまみながら本音トーク  
6人の講師の何処でも自由に往来できるシステム)

7/13(金)

- 8:00～ 朝食
- 8:45～ 日帰り参加者受付
- 9:00～ ポスターアブストラクトトーク 第1部
- 10:00～ ポスターセッション 第1部
- 11:30～ 基調講演 第1部 (プレゼンテーション 50分×1名)
- 12:30～ 昼食
- 13:30～ 基調講演 第2部 (プレゼンテーション 50分×1名)
- 14:30～ ポスターアブストラクトトーク 第2部
- 15:30～ ポスターセッション 第2部
- 17:00～ ITRI(台湾)における技術の産業化
- 17:30頃 解散予定

参加費 ●全参加2日間コース (会員) 30,000 円  
 (非会員) 35,000 円

- \* イブニングセッション
- \* レセプション&宿泊費
- \* ナイトセッション
- \* 2日目ワークショップ参加費 (昼食費は含まれません)

●日帰り1日コース (会員) 20,000 円 (非会員) 25,000 円

- \* 2日目ワークショップ参加費のみ (昼食費は含まれません)

\*申し込みは開催10日前まで受け付けますが、トータル120名になり次第締め切らせて頂きます。

\*会員価格は、JIEP 会員ならびに協賛団体会員の方を対象といたします。

参加申込み エレクトロニクス実装学会ホームページ <https://web.jiep.or.jp/kansai/event.html> よりお願いいたします。



最寄駅 大阪モノレール『宇野駅』からリゾート大阪まで徒歩約8分 (シャトルバスもごさいます)

[https://phio.panasonic.co.jp/resort/r\\_osaka/index.htm](https://phio.panasonic.co.jp/resort/r_osaka/index.htm)

## \* ポスターセッション

### ●3Dインテグレーション

『3D-In-Mold Electronics』

『ケミカルダイシングの実用化に向けたアルミ電極保護技術』

『シリコン基板上に形成した無電解めっきバリア合金膜の熱安定性評価』

『異種テクノロジーの3次元実装を支援する半導体/パッケージ/PCB 協調設計プラットフォーム』

恒業精密工業有限公司

(株)東芝

関西大学

(株)図研

福井 俊晴氏

佐野 光雄氏

井芹 崇樹氏

古賀 一成氏

### ●カーエレクトロニクス・パワーエレクトロニクス

『定常熱勾配法による熱伝導特性評価』

『次世代パワーデバイスなどに用いられる超音波接合技術』

大阪大学

超音波工業(株)

佐藤 直樹氏

濱田 賢祐氏

### ●接合・インターコネクト

『無加圧接合用焼結 Cu ダイボンド材料の開発』

『常温接合・剥離技術の装置販売、紫外線表面処理』

『最新ディスプレイモジュールに向けた表示駆動用 IC の実装技術開発 (狭ピッチ/狭領域化を実現する IC 接続材料及び構造設計について)』

『大気キュア可能な銅系導電接着剤の開発と信頼性評価』

日立化成(株)

ランテックニカルサービス(株)

シャープ(株)

群馬大学

川名 祐貴氏

植田 力氏

松井 隆司氏

瓦井 健太氏

### ●基板、パッケージ、部品内蔵

『MID(Molded Interconnect Device)用銅ペースト』

『可視光域で透明なコーティングを使った輻射による放熱(仮)』

『電磁メタマテリアルを用いたノイズ抑制技術の開発』

『Fan-Out Wafer Level Package 技術を用いたパッケージ一体型テラヘルツ波アンテナ』

日立化成(株)

合同インキ(株)

大阪産業技術研究所

(株)富士通研究所

米倉 元氣氏

三好 輝氏

伊藤 盛通氏

石橋大二郎氏

### ●めっき

『導電性銅ナノインクを用いた回路形成』

『難メッキ材料への直接銅メッキを可能とするプラズマ表面改質技術』

『シリコン上への直接無電解めっきを用いた電極形成』

『ナノ Ag 触媒を利用した MSAP による微細回路形成技術』

石原ケミカル(株)

(株)電子技研

兵庫県立大学

奥野製薬工業(株)

有村 英俊氏

小泉 剛氏

八重 真治氏

北原 悠平氏

### ●ナノ材料・ナノペースト

『ファインマテリアル「フルオレン」の実装材料への応用』

『スプレー塗布可能な EMI シールド用銀ペーストの開発』

大阪ガスケミカル(株)

ナミックス(株)

安田祐一郎氏

坂井 徳幸氏

### ●機能材料・複合材料

『光と熱にフォーカスした複合材料の UV 硬化』

『自己修復性ポリマーゲル』

『新規植物由来の水溶性ノニオンポリマーKT-1505(仮)』

『引抜成形による鉄道車両用不燃性FRP(Fiber Reinforced Plastics)』

『日系企業の台湾エレクトロニクス市場での事業展開について』

共栄社化学(株)

ユシロ化学工業(株)

DSP 五協フード&ケミカル(株)

福井ファイバーテック(株)

花王台湾股份有限公司

池田 順一氏

高橋 宏明氏

窪田真太郎氏

小宮 巖氏

作本 光央氏

### ●フレキシブルエレクトロニクス

『自己修復型金属配線を用いた伸縮電子デバイス(仮)』

『金属調光沢材料』

『Roll to Roll サブミクロン印刷技術を用いた透明導電膜の開発』

『フレキシブル基板へのマイクロ波を用いたはんだ溶融による電子部品実装技術の開発』

早稲田大学

住友精化(株)

旭化成(株)

産業技術総合研究所

古志 知也氏

藤本 信貴氏

小松 和磨氏

金澤 賢司氏

### ●MEMS、バイオ、医療

『ウェアラブルセンサーによる多電極心電システムの開発』

『電気回路印刷技術と紙流体チップの融合による新機能開拓』

『自然にまなぶ薬剤耐性フリー抗菌剤のデザイン』

名古屋大学医学部附属病院

早稲田大学

奈良先端科学技術大学院大学

檜 顕成氏

松田 佑氏

安原 主馬氏

### ●製造装置関係

『ウェットプラストエ工法のご紹介(仮)』

『エッチング加工から精密バンテングプレスでコストダウン』

『プラズマダイシング技術』

『オンデマンド 3D 電子モジュール製造システム』

『NCF を用いたマルチダイー括実装技術』

マコー(株)

旭鍍金工業(株)

SPP テクノロジーズ(株)

(株)FUJI

東レエンジニアリング(株)

小方 雅淑氏

三品 一幸氏

金尾 寛人氏

塚田 謙磁氏

田中 寛人氏

### ●環境、評価

『銅系材料を用いた接合剤の開発』

『HALT (Highly Accelerated Limit Test)におけるストレスの効果』

『撥水性及び潤滑性を付与するナノスケール金属酸化膜処理の開発』

『各種放熱グリースの実装状態での熱抵抗評価』

日華化学(株)

エスベック(株)

(株)友電舎

(株)東レリサーチセンター

斉藤 雄介氏

Pihet Raphaël 氏

田島 秀春氏

関 伸弥氏

### ●オプト・フォトソグラフィ

『ビックリするほどでっかいLEDモジュールの開発』

『パッケージングプロセス向け先端フォトレジスト材料』

『高精度なリソグラフィパターン形成が可能な有機永久構造材料』

四国計測工業(株)

東京応化工業(株)

東京応化工業(株)

村上 昭二氏

川上 晃也氏

安藤 友之氏

### ●CAE、AI応用

『五感を科学的に解析する次世代のモノ・コトづくり支援』

『最適化問題の自動階層分割手法と3DLSI 概略設計への適用』

『材料開発に特化した3つの人工知能技術』

パナソニック(株)

大阪大学

日本電気(株)

野田 聡氏

岩田 剛治氏

澤田 亮人氏

主催 エレクトロニクス実装学会 関西支部 【問い合わせ先】 E-mail: ws-kansai@jiep.or.jp

協賛: 日本ロボット工業会 (JARA)、日本電子回路工業会 (JPCA)、溶接学会マイクロ接合研究委員会、表面技術協会関西支部

応用物理学会関西支部、日本機械学会関西支部、日本材料学会関西支部、日本金属学会関西支部、高分子学会関西支部、電気学会関西支部

電子情報通信学会関西支部、日本接着学会関西支部、日本信頼性学会関西支部、スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会

\*発表テーマは仮題を含みます。講師、内容は変更になる場合があります。また、ご希望のセッションやポスターが選定されない場合もありますので予めご了承下さい。